

<<电子产品生产与组装工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子产品生产与组装工艺>>

13位ISBN编号：9787118080261

10位ISBN编号：7118080268

出版时间：2012-4

出版时间：国防工业出版社

作者：王为民，刘岚 主编

页数：192

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子产品生产与组装工艺>>

内容概要

《电子产品生产与组装工艺》是从电子产品制造的实际出发，按照电子产品生产工艺要求的顺序进行编写，主要包括：常用电子元件的识别与检测、常用电子材料的识别、电子元器件的焊接及工艺、电子产品的组装及工艺、电子产品的调试、电子产品的检验与包装。全书共6章，每章均有思考与练习。

读者通过学习本书内容，既能够掌握生产操作中的基本技能，又能从工艺工程师、管理人员的角度认识电子产品的生产全过程。本书可作为中、高等职业学校的电子信息、电子应用或smt类专业课程的教材，也可作为电子爱好者和一些制造业现场管理、操作人员等的教材与自学参考书。

书籍目录

第1章 常用电子元器件的识别与检测

- 1.1 电阻器的识别与检测
 - 1.1.1 电阻器的分类
 - 1.1.2 电阻器和电位器的型号命名方法
 - 1.1.3 电阻器的主要技术指标
 - 1.1.4 电阻器的识别方法
 - 1.1.5 电阻器的检测
- 1.2 电容器的识别与检测
 - 1.2.1 电容器的分类
 - 1.2.2 电容器的型号命名方法
 - 1.2.3 电容器的主要技术指标
 - 1.2.4 电容器的识别方法
 - 1.2.5 电容器的检测
- 1.3 半导体分立元器件的识别与检测
 - 1.3.1 半导体器件的分类
 - 1.3.2 半导体器件的型号命名法
 - 1.3.3 半导体器件的主要技术指标
 - 1.3.4 半导体器件的检测
- 1.4 集成电路的识别与检测
 - 1.4.1 集成电路的分类
 - 1.4.2 集成电路的型号命名方法
 - 1.4.3 集成电路的识别
 - 1.4.4 集成电路的检测
- 1.5 电感器和变压器的识别与检测
 - 1.5.1 电感器和变压器的分类
 - 1.5.2 电感器和变压器的主要技术指标
 - 1.5.3 电感器和变压器的检测
- 1.6 压电元件和霍耳元件的识别与检测
 - 1.6.1 压电元件和霍耳元件的分类
 - 1.6.2 压电元件和霍耳元件的主要技术指标
 - 1.6.3 压电元件和霍耳元件的检测
- 1.7 表面安装元器件的识别与检测
 - 1.7.1 表面安装元器件的分类
 - 1.7.2 表面安装元器件的包装种类
 - 1.7.3 表面安装元器件的使用要求与选择

思考与练习

第2章 常用电子材料的识别

- 2.1 导线
 - 2.1.1 导线的分类
 - 2.1.2 导线的命名方法
 - 2.1.3 导线的选用
- 2.2 绝缘材料
 - 2.2.1 绝缘材料的分类
 - 2.2.2 绝缘材料的性能指标
 - 2.2.3 绝缘材料的用途

<<电子产品生产与组装工艺>>

2.3 磁性材料

2.3.1 磁性材料分类

2.3.2 常用磁性材料的主要用途

2.4 印制电路板

2.4.1 覆铜箔板的种类与选用

2.4.2 印制电路板的特点及分类

2.5 黏合剂

2.5.1 常用黏合剂的类型

2.5.2 常用黏合剂的特点与应用

2.6 焊接材料

2.6.1 焊料

2.6.2 助焊剂

2.6.3 阻焊剂

思考与练习

第3章 电子元件的焊接工艺

3.1 手工锡焊

3.1.1 手工锡焊工具

3.1.2 手工锡焊的方法与技巧

3.1.3 手工锡焊的质量判定

3.2 手工拆焊

3.2.1 手工拆焊的工具

3.2.2 手工拆焊的操作技巧

3.3 自动锡焊

3.3.1 自动锡焊设备

3.3.2 自动锡焊工艺

3.3.3 贴片元件的手工操作

思考与练习

第4章 电子产品的组装及工艺

4.1 电子产品的组装概述

4.1.1 电子产品的组装内容与工序

4.1.2 电子产品的整机组装

4.1.3 电子产品的整机组装专用设备介绍

4.1.4 电子产品整机组装中的静电防护

4.2 元器件的组装工艺

4.2.1 常用元器件的组装要求和方法

4.2.2 压接、绕接和螺纹连接

4.3 表面贴片元件的组装及工艺

4.3.1 表面贴片元件组装用到的材料

4.3.2 表面贴片元件设备

思考与练习

第5章 电子产品组装后的调试

5.1 概述

5.1.1 常用调试设备配置

5.1.2 调试的内容和程序

5.1.3 调试的一般流程

5.2 调试的一般工艺

5.2.1 调试工艺的要求

<<电子产品生产与组装工艺>>

5.2.2 调试前的准备

5.2.3 单元部件调试的一般工艺流程

5.2.4 整机调试的一般工艺流程

5.2.5 整机的调试类型

5.2.6 调试的安全措施

5.2.7 整机电路调试实例

思考与练习

第6章 电子产品的检验和包装

6.1 电子产品的检验

6.1.1 电子产品检验的目的和方法

6.1.2 电子产品的检验内容

6.2 电子产品的包装

6.2.1 电子产品的包装类型及要求

6.2.2 电子产品的包装材料

6.2.3 电子产品包装的标志

思考与练习

附录思考与练习参考答案

参考文献

<<电子产品生产与组装工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>